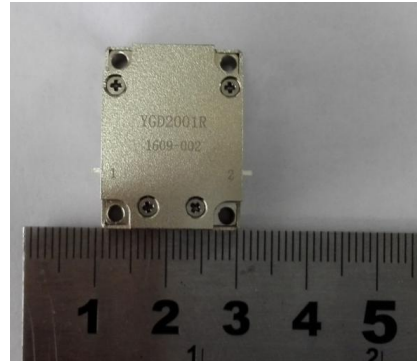


特点：

- 正向插损：≤0.7dB
- 反向隔离度：≥18dB
- 电压驻波比：≤1.35
- 工作温度：-55~+85℃
- 腔体封装
- 封装尺寸：25*19*11mm(不含玻珠针)
- 产品执行标准为 GJB1065A-2004
企业规范为 Q/YX2201-2016

图片



性能参数：

参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\ \Omega$	960		1224	MHz
正向插损	IL	$Z_{in}=Z_{out}=50\ \Omega$ $f=960\text{MHz}\sim 1224\text{MHz}$			0.7	dB
反向隔离度	ISO		18			dB
电压驻波比	VSWR				1.35	
功率容量	P				20	W
工作温度	T		-55		+85	℃
质量	m				50	g

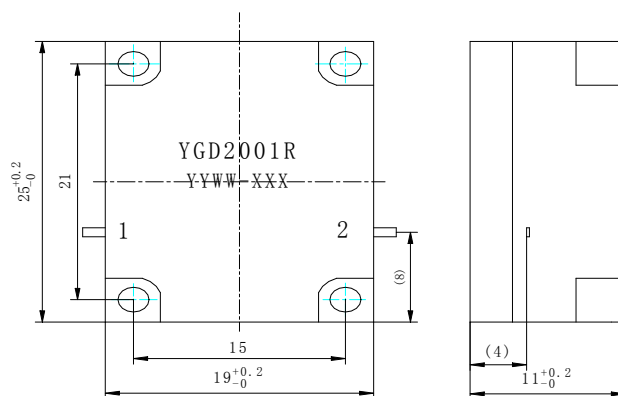
储存条件：产品应储存在环境温度-10℃~+40℃、相对湿度≤80%、周围无酸性、碱性及其他有害气体的库房中。

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
贮存温度	-55~+125	℃	输入功率	20	W

封装外形图：

单位：mm 未注公差：±0.1mm



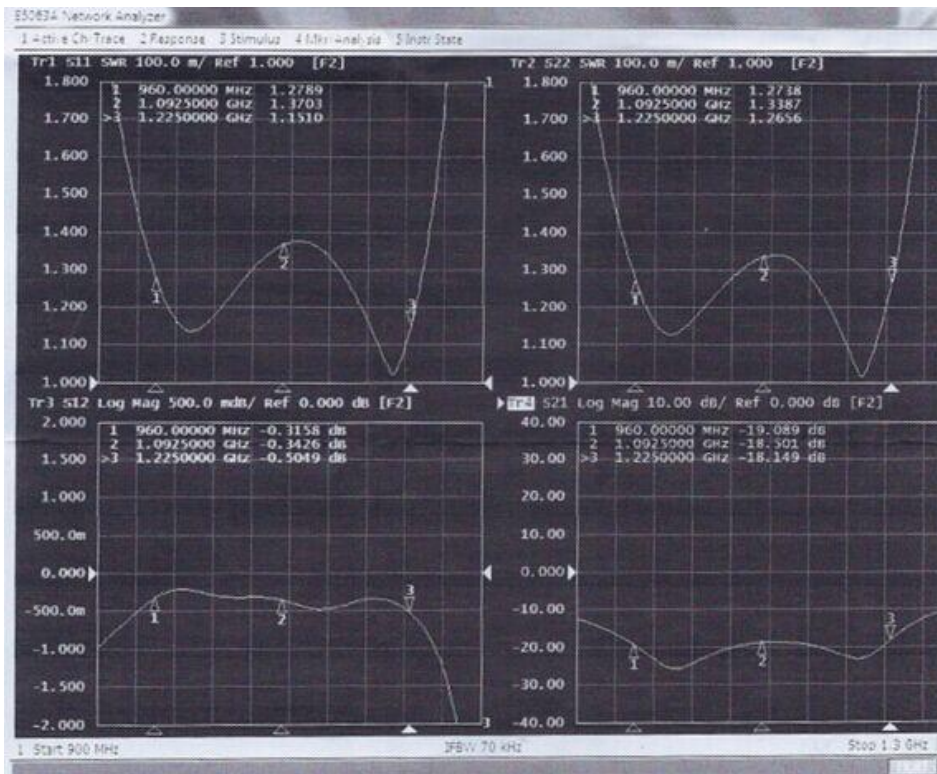
字符标志：

YDG2001R	产品型号
1	1 脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义：

引脚	定义
1	RF IN
2	RF OUT
腔体	GND

特性曲线:



产品使用注意事项:

1. 隔离器属于磁性器件，使用和存放需远离永磁和导磁环境；
2. 隔离器应用时应远离铁磁性物质（大于 5 毫米），并使用非磁性螺钉；
3. 隔离器内部有磁性材料，转运及使用过程中应注意防护，避免跌落导致内部磁性材料破损；
4. 使用过程中应注意工艺环境温度控制，隔离器不建议采用回流焊接；
5. 产品使用时应确保接地良好，且端口引出线应避免弯折；
6. 产品组装时应先装配后焊接，避免焊接后再装配焊点受力影响连接可靠性。